

**ナノテクノロジープラットフォーム  
研究支援に提供する設備一覧  
【微細加工プラットフォーム】**

機関名	設備(設備群)名	仕様	備考
大阪大学	超高精細電子ビームリソグラフィ装置	エリオニクス製 ELS-100T 加速電圧:125keV 試料サイズ:6inch	
大阪大学	高精細電子線リソグラフィ装置	エリオニクス社製 ELS-7700T 加速電圧:75keV 試料サイズ:6inch	
大阪大学	電子ビームリソグラフィ装置	JEOL社製 JSM6500F with Beam Draw 試料サイズ:2inch 加速電圧:30keV	
大阪大学	集束イオンビーム装置	日立ハイテクサイエンス社製 SMI2050 ステージサイズ:2inch C銃、W銃装備、電子銃:500eV 加速電圧:30keV 最小ビーム径:4nm	
大阪大学	収束イオンビーム誘起化学蒸着装置	ZEISS社製 Nvision 40D with NPVE ステージサイズ:max 8inch Pt銃、SiO2銃装備 FE-SEMユニット、加速電圧:30keV 検出器:InLens、SE、Esb FIBユニット、加速電圧:30keV 最小ビーム径:4nm	
大阪大学	深掘りエッチング装置	サムコ社製 RIE-400IPB-NP 試料サイズ:max 4inch プロセスガス:CF4、C4F8、CHF3、SF6、O2、Ar	
大阪大学	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ社製 RIE-10NR-NP 試料サイズ:max 8inch プロセスガス:CF4、CHF3、SF6、O2、Ar、N2	
大阪大学	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ社製 RIE-10NOU プロセスガス:CF4、O2、Ar、N2	
大阪大学	RFスパッタ成膜装置	サンヨー電子社製 SVC-700LRF ・金属成膜用RFスパッタ 試料サイズ:max 4inch	
大阪大学	RFスパッタ成膜装置	サンヨー電子社製 SVC-700LRF ・絶縁体成膜用RFスパッタ 試料サイズ:max 4inch	
大阪大学	ナノ薄膜形成システム (EB蒸着、アークプラズマ蒸着)	アルバック社製 UEP-2000 OT-H/C 試料サイズ:max 4inch EB蒸着ユニット アークプラズマユニット	
大阪大学	マスクアライナー	ミカサ社製 MA-10	
大阪大学	LED描画システム	ピーエムティー社製 PLS-1010	
大阪大学	イオンシャワーエッチング装置	エリオニクス社製 EIS-200ER ガス:CF4、Ar	
大阪大学	ナノインプリント装置	Obducat社製 Eitre 3 熱・UVの両方式に対応 試料サイズ:3inch	
大阪大学	多元DC/RFスパッタ装置	キャノンアネルバ社製 EB1100 試料サイズ:max 6inch	
大阪大学	高精細集束イオンビーム装置	カールツァイス社製 ORION NanoFab Heビーム / 加速電圧30kV / 分解能0.5nm Neビーム / 加速電圧30kV / 分解能1.9nm Pt銃、SiO2銃、XeF2銃装備	